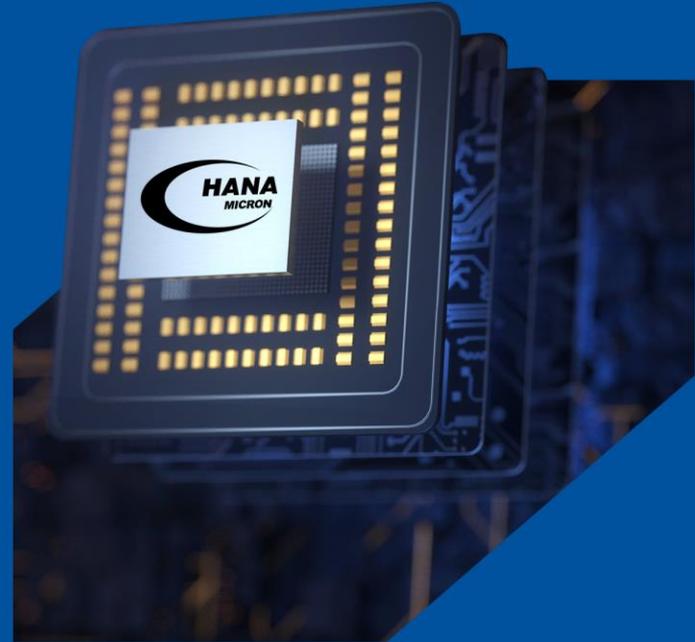


INVESTOR RELATIONS 2025

INNOVATIVE SEMICONDUCTOR SOLUTION PROVIDER

고객의 Needs에 맞는 최적의 솔루션을 찾아 제안합니다.



DISCLAIMER

본 자료는 하나마이크론(주)(이하 “회사”)의 주주 및 투자자에 대한 정보 제공의 목적으로 작성되었으며 본 자료를 복사, 재생, 배포 또는 게재하거나 다른 목적으로 사용하는 것은 엄격히 금지됩니다. 본 presentation에 참석하는 경우 위 내용에 대한 동의로 간주되며 만일 위 사항을 위반하는 경우 동시에 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’의 위반에도 해당 될 수 있음을 유념하시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별적인 확인 절차를 거치지 않은 정보입니다. 이는 과거가 아니라 향후 예상되는 미래의 회사 경영현황 및 재무실적을 의미하는 것으로서, ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어가 사용된 경우는 “예측정보”를 가리킵니다.

“예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 영향을 받을 수 밖에 없어 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제의 미래실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 presentation 실시일 현재의 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려하여 작성된 것으로서 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 투자자에 대한 별도의 고지 없이 변경될 수 있습니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 과실 등의 여부를 불문하고 어떠한 책임도 부담하지 아니합니다.

본 자료는 주식의 모집 또는 매매의 청약에 대한 권유에 해당되지 아니합니다.



Better Solution for a Better Tomorrow

끊임없는 기술혁신으로
반도체의 새로운 가치를 만들어 갑니다.

TABLE OF CONTENTS

Chapter 01. '25.2분기 실적

Chapter 02. 시장 전망 및 사업현황

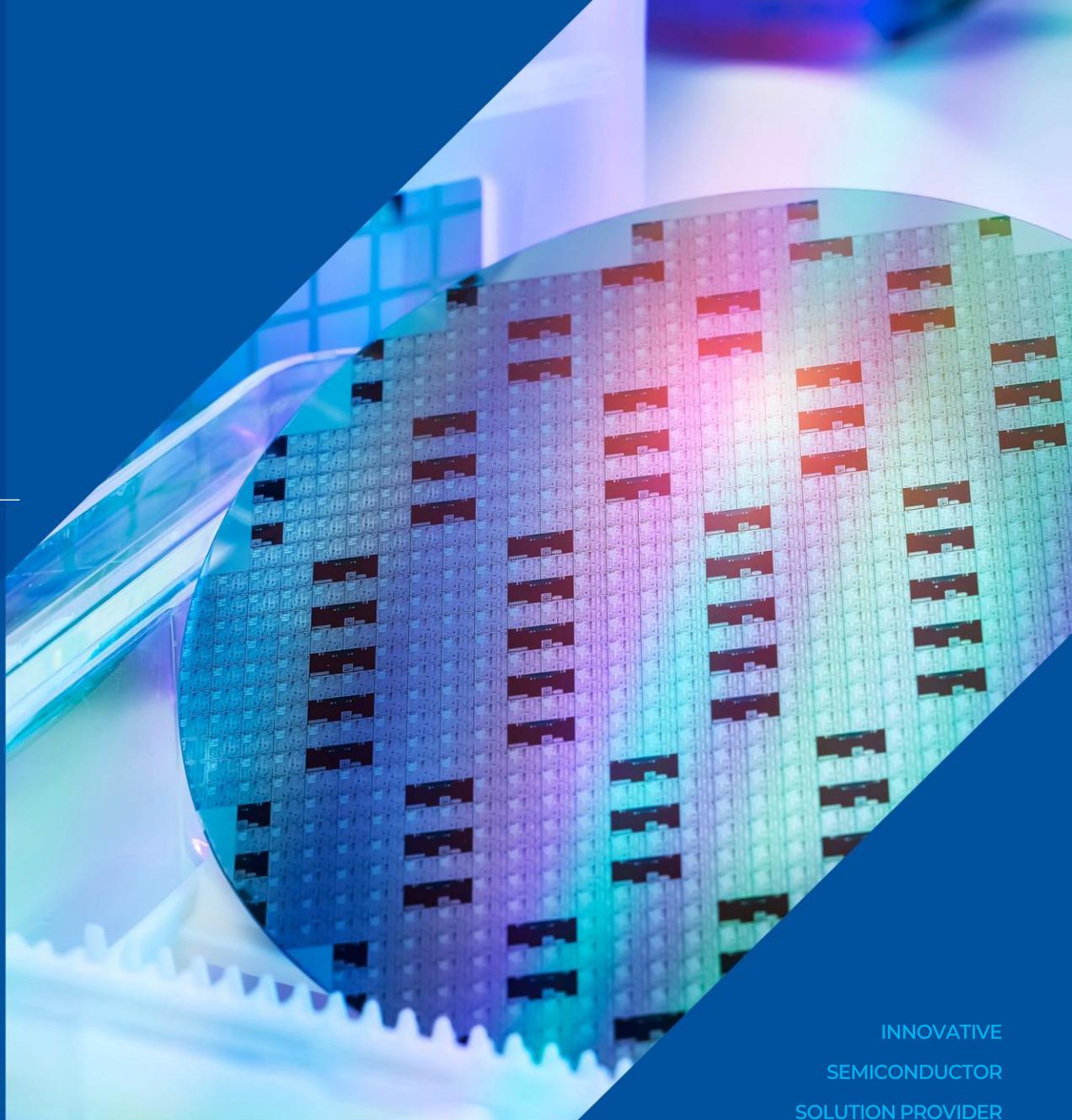
APPENDIX



01

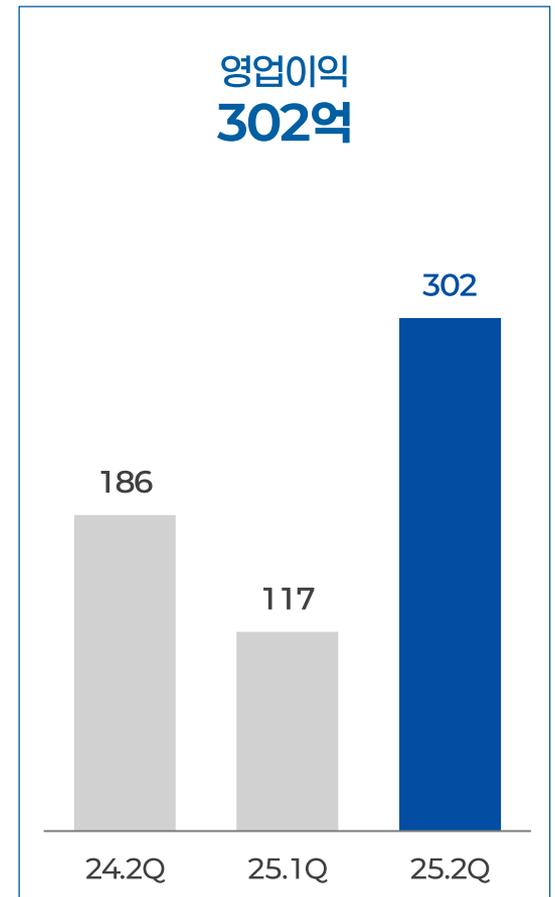
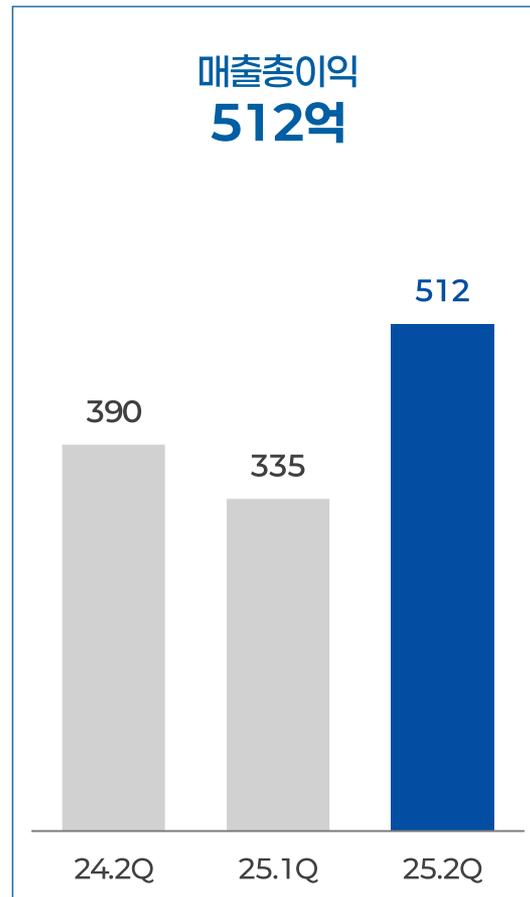
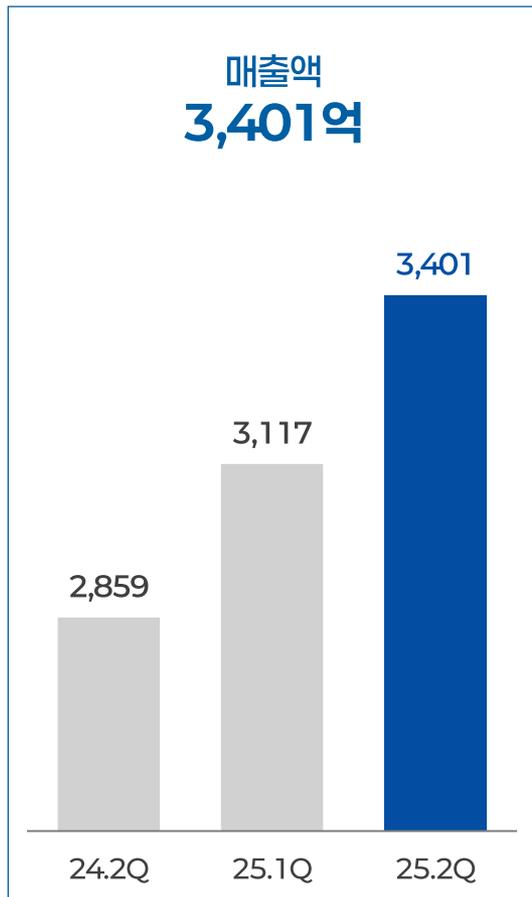
'25.2분기 실적

1. 2분기 경영실적 요약 (연결기준)
2. 2분기 경영실적 및 재무현황 (연결기준)
3. 사업부문별 매출 및 영업이익
4. 실적 및 전망 분석



INNOVATIVE
SEMICONDUCTOR
SOLUTION PROVIDER

전년 동기 比 매출액 19%, 영업이익 62.3% 증가



02. 2분기 경영실적 및 재무현황 (연결기준)

단위: 억원	24.2Q	비중	25.1Q	비중	25.2Q	비중
매출액	2,859	100.0%	3,117	100.0%	3,401	100.0%
매출원가	(2,469)	-86.4%	(2,782)	-89.2%	(2,889)	-84.9%
매출총이익	390	13.6%	335	10.8%	512	15.1%
판매비	(204)	-7.1%	(218)	-7.0%	(210)	-6.2%
영업이익	186	6.5%	117	3.8%	302	8.9%
순금융비용	(170)	-5.9%	(164)	-5.3%	(164)	-4.8%
법인세차감전이익	(131)	-4.6%	33	1.1%	85	2.5%
법인세비용	38	1.3%	(27)	-0.9%	(14)	-0.4%
순이익	(93)	-3.2%	6	0.2%	71	2.1%

주요 재무현황			단위: 억원
구분	24.2Q	25.1Q	25.2Q
자 산	17,910	19,656	19,100
부 채	12,719	13,688	13,257
자 본	5,191	5,968	5,843

주요 재무 지표			
구분	24.2Q	25.1Q	25.2Q
총자산 회전율	0.64회	0.63회	0.71회
부채비율	245.0%	229.4%	226.9%
영업이익율	6.5%	3.8%	8.9%
EBITDA 마진	18.6%	15.9%	19.9%

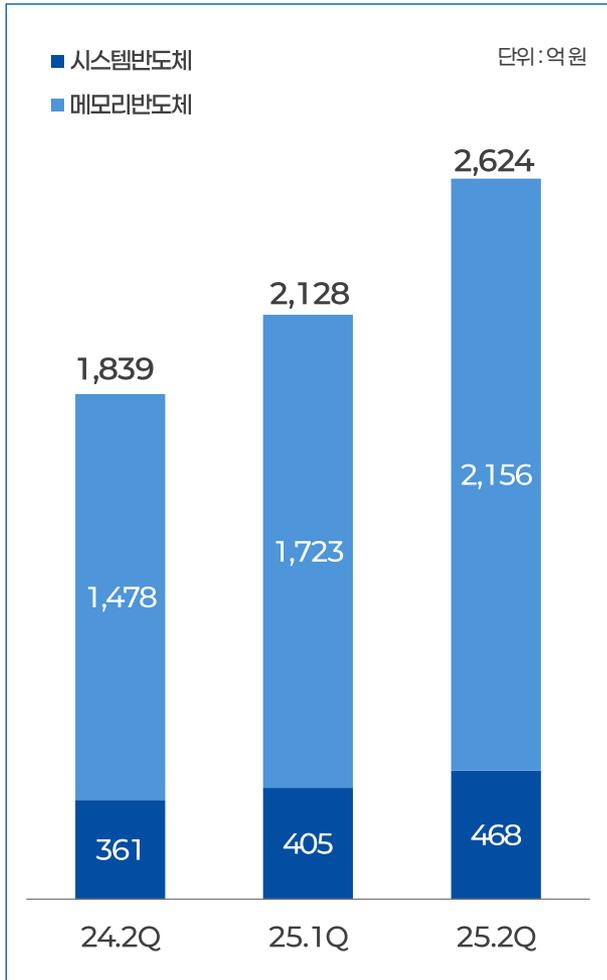
03. 사업부문별 매출 및 영업이익

매출					
	24.2Q	25.1Q	25.2Q	QoQ	YoY
총액	2,859	3,117	3,401	9.1%	19.0%
반도체 제조	2,239	2,531	2,760	9.1%	23.3%
메모리	1,889	2,097	2,256	7.6%	19.5%
시스템 반도체	350	434	504	16.1%	44.0%
반도체 재료	618	583	639	9.6%	3.4%
신기술사업금융	2	3	2	-41.6%	-2.0%

영업이익					
	24.2Q	25.1Q	25.2Q	QoQ	YoY
총액	186	117	302	157.3%	62.3%
반도체 제조	90	30	217	618.1%	141.1%
반도체 재료	97	87	86	-1.3%	-11.0%
신기술사업금융	(1)	(0)	(1)	-	-

※ 반도체 제조 : 하나마이크론 본사, 베트남 법인, 브라질 법인
반도체 재료 : 하나머티리얼즈

04. 실적 및 전망 분석 (1)반도체 제조(본사, 한국)



'25.2분기 실적

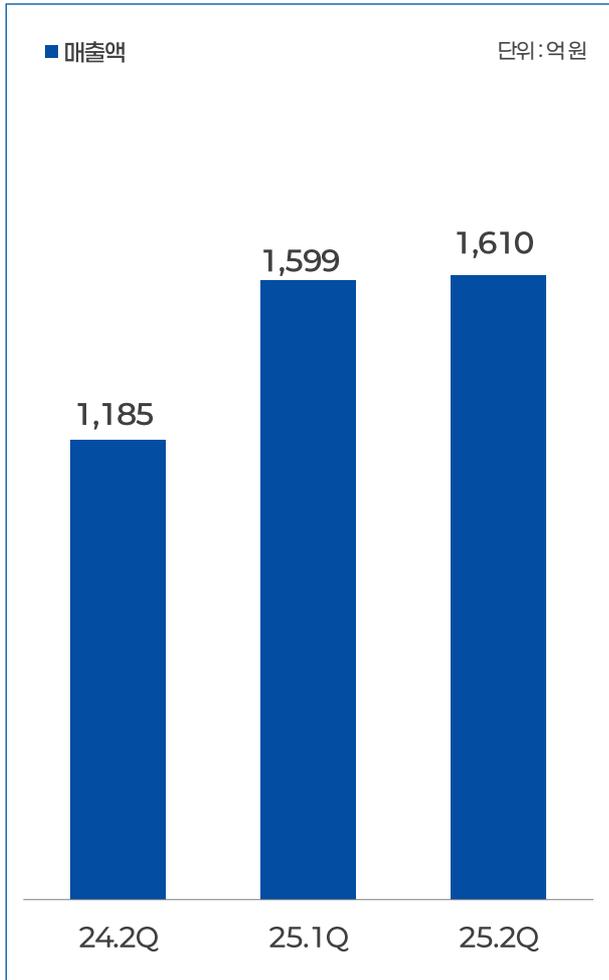
- ✓ 매출 전년동기比 42.6%↑, 전분기比 23.3%↑
- ✓ 메모리
 - eMMC, eMCP 등 모바일 向 수요 감소, 서버 向 Dram 수요 증가
- ✓ 시스템반도체
 - AP, RF, D-TV 向 제품 Pull-in 생산 → Flagship AP 제품 수주 물량 증가

'25.하반기 전망

- ✓ 메모리
 - PC/서버 向 DDR5 및 신제품(eUFS) 증량 전망
- ✓ 시스템반도체
 - 신규 Flagship 向(S26) AP 제품 생산 및 중저가(A 시리즈) 제품 탑재 확대
 - Automotive Power Module 및 Large body FCBGA 제품 양산 전망

※ 연결 내부거래 조정 前 별도 재무제표 기준

04. 실적 및 전망 분석 (2)반도체 제조(베트남)



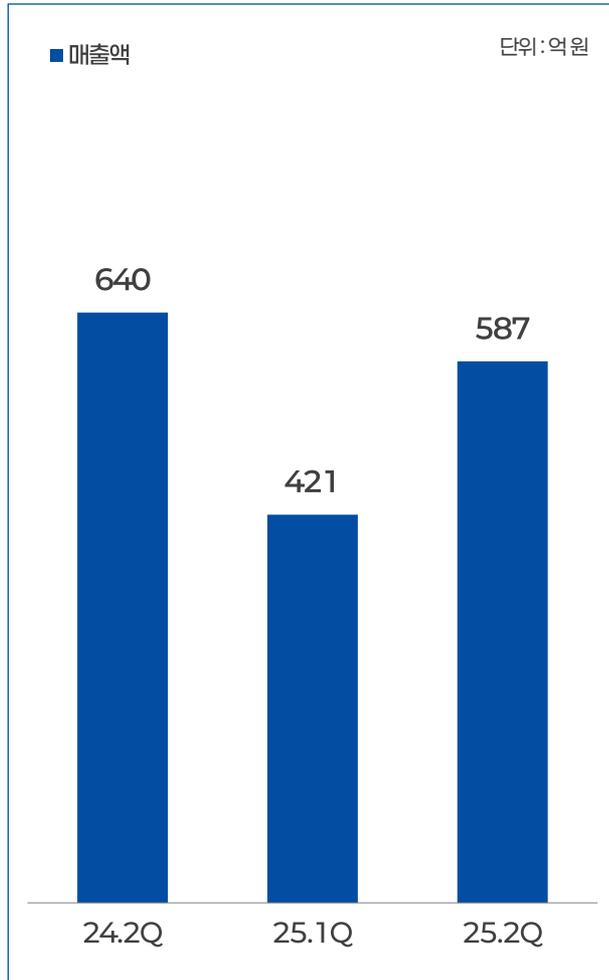
‘25.2분기 실적

- ✓ 매출 전년동기比 35.8%↑, 전분기比 0.7%↑
- ✓ 생산Capa 확대 → DDR5/SSD 증량으로 전년동기比 매출 38% 증가
- ✓ 시스템반도체 전용 생산 Line 확장 준비 中

‘25.하반기 전망

- ✓ DDR5 수주 물량 지속 증가 → 연간 전년대비 매출 50% 성장전망
- ✓ 시스템반도체 생산 확대
 - FPS → W/B, F/C, UFD 등 생산 Line 확대 운영

04. 실적 및 전망 분석 (3)반도체 제조(브라질)



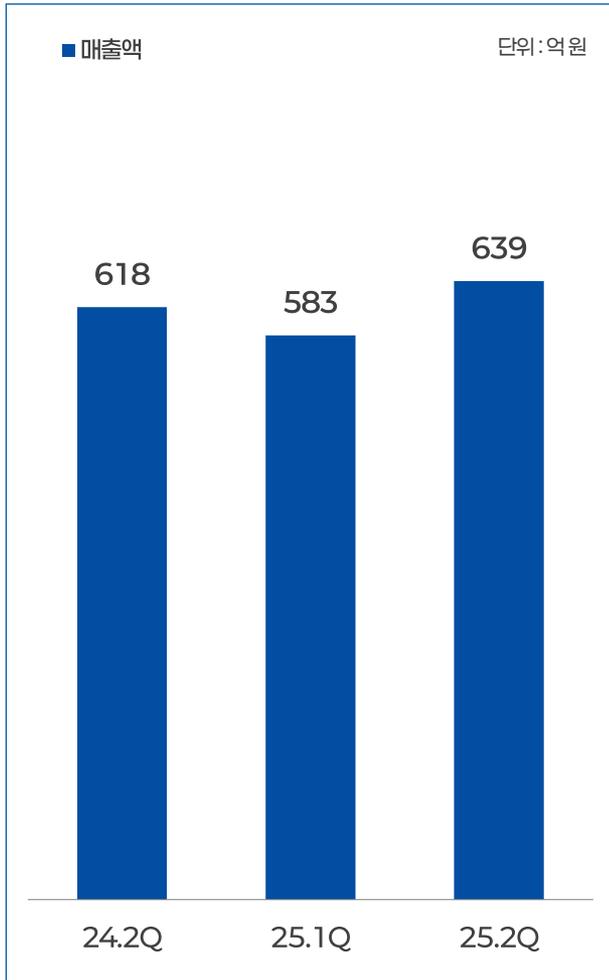
'25.2분기 실적

- ✓ 전년동기比 8.3%↓, 전분기比 39.4%↑
- ✓ 브라질 IT시장 위축 및 고객 수요 감소 → 전년동기 대비 판매 감소
- ✓ 메모리 가격 상승 및 신규반도체법(NewPADIS) → 수익성 개선

'25.하반기 전망

- ✓ PC向 DDR5 판매 본격화(Dell 승인完) 및 모바일 고용량 메모리 적용 비중 상향
- ✓ DRAM 가격 지속 강세 → 매출 및 수익성 상승 전망

04. 실적 및 전망 분석 (4)반도체 재료



'25.2분기 실적

- ✓ 전년동기比 3.4%↑, 전분기比 9.6%↑
- ✓ 반도체 Dry Etching 공정 실리콘 소재 부품 전문 기업
- ✓ 1분기 고객사의 재고 소진 영향으로 매출 감소하였으나, 2분기 재고 축적 수요 증가로 전분기 대비 매출 개선

'25.하반기 전망

- ✓ 고객사의 물량 증가로 인한 수요 증가 전망
- ✓ NAND 및 DRAM 가동률 개선 → Parts 수요 증가



02

시장 전망 및 사업현황

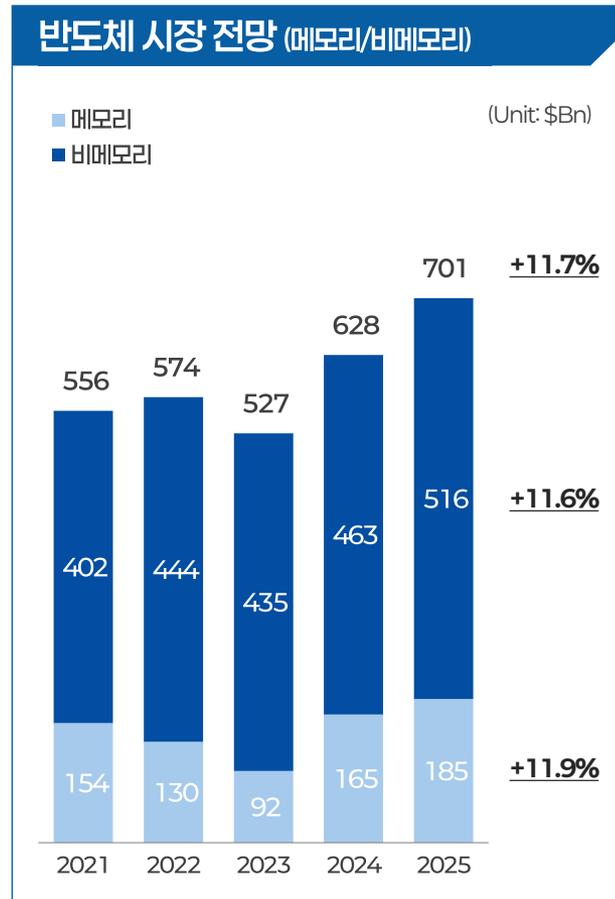
1. 반도체 시장 전망
2. 반도체 패키징 시장 전망
3. 반도체 패키징 기술동향
4. 어드밴스드 패키지 개발 현황
5. 전시회 참가 (KPCA SHOW 2025)
6. 중장기 성장 로드맵



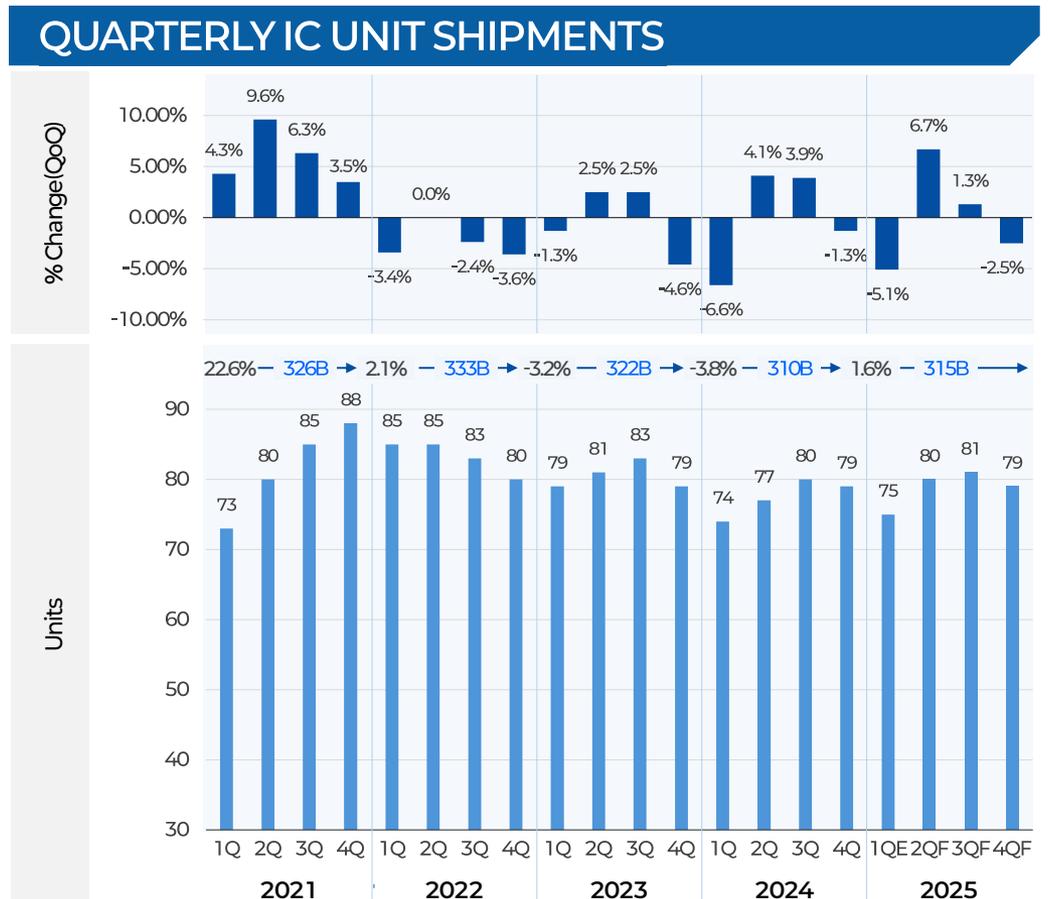
INNOVATIVE
SEMICONDUCTOR
SOLUTION PROVIDER

01. 반도체 시장 전망

- 2025년 AI관련 서버/데이터센터 중심 반도체 시장 성장 (YoY 11.7%↑)
- 상반기 美 관세 불확실성에 따른 재고확대 영향으로 4분기 수요 소폭 하락 가능성



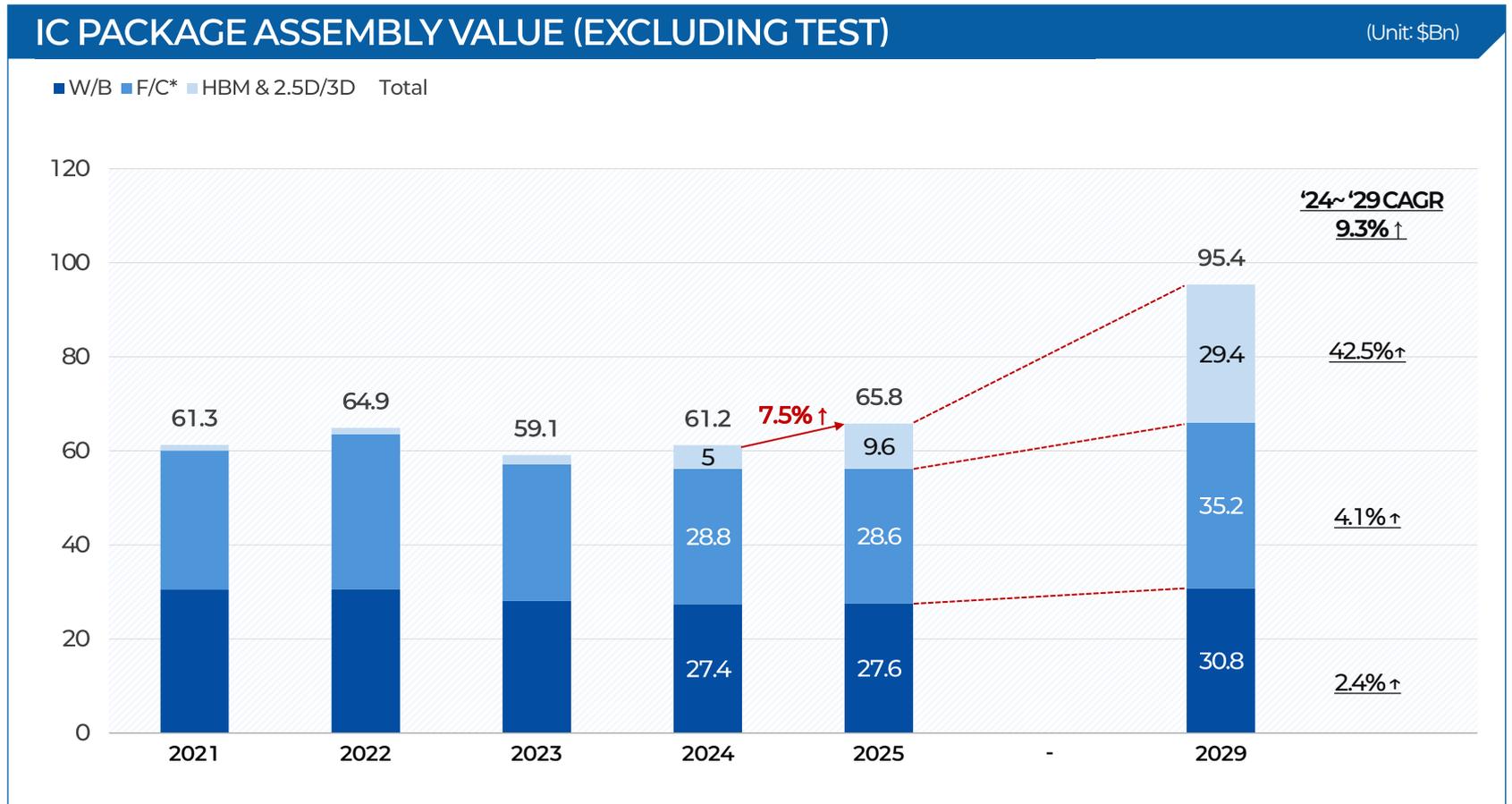
* 출처: WSTS, 반도체산업협회 보고서(2025.7.25)



* 출처: Prismark 보고서(2025.7.7)

02. 반도체 패키징 시장 전망

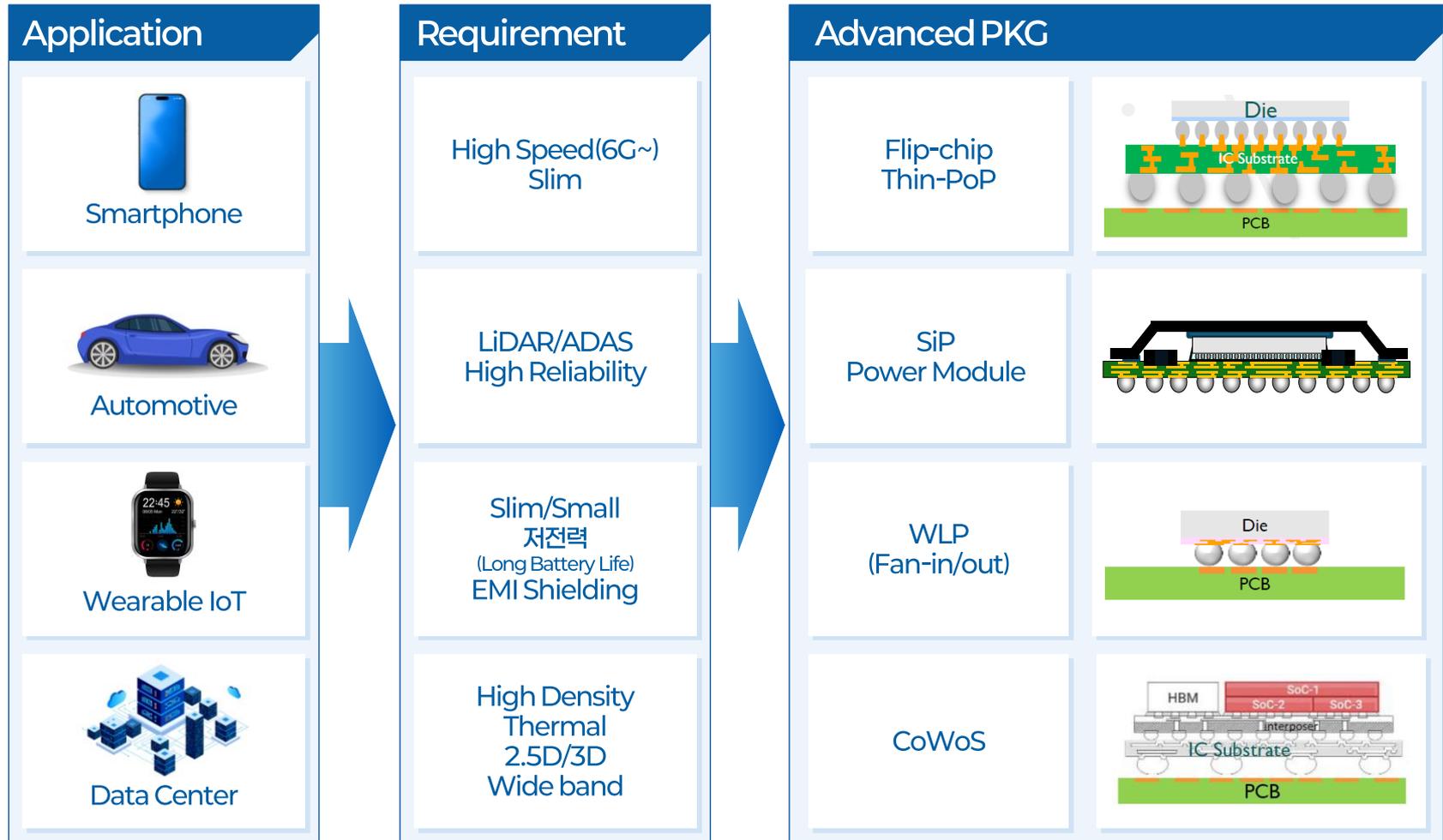
- AI제품 성장과 함께 HBM, 2.5D/3D 패키징 중심 성장 지속



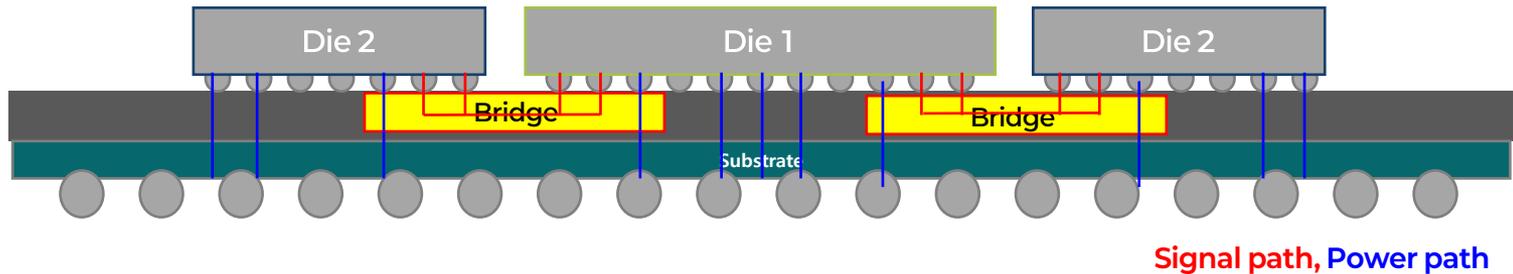
1) F/C: HBM 및 2.5D/3D 패키지 미포함

*출처: Prismark 보고서 (2025.7.7)

03. 반도체 패키징 기술동향



HANA concept

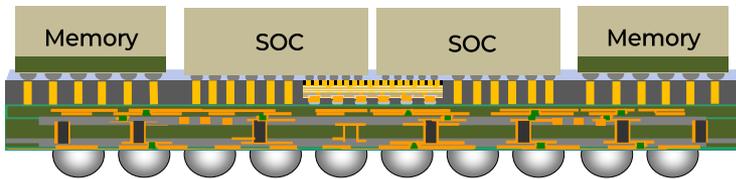


Key Tech : Bridge Die on PCB
 Top/Btm Interconnection (in Bridge Die)
 Conventional Process

HIC-Bridge Die

국내 H社
 ADAS

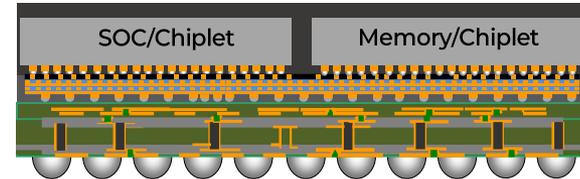
국내 L社 T社
 Smart home/Automotive



HIC-RDL Interposer

국외 S社/M社
 IOT Computing

국내 Q社
 UCle IP



05. 전시회 참가 (KPCA SHOW 2025)

• 국내 최대 규모의 전자회로 및 반도체 패키징 전문 전시회 참가

- 행사명 : KPCA SHOW 2025 (국제 첨단 반도체 기판 및 패키징 산업전)
- 일정 : 2025년 9월 3일(수) ~ 5일(금)
- 장소 : 인천 송도컨벤시아
- 참가 목적 : 하나마이크론 첨단 패키징 기술 소개 및 국내외 고객 영업
- 전시 제품 : 2.xD Chiplet Integration, SiP, OPTIC, ToF, LiDAR Tx, Memory Module 등



06. 중장기 성장 로드맵

• 2030년 Global Top 5 OSAT 기업으로 도약



1. Advanced PKG

2.xD & Chiplet Bridge Die

AiP
(Antenna in Package)

CPO Module
(Co-Packaged Optics)

SiC Power Module

2. Optical Sensors

(Optical Design & 3D Evaluation)
Time of Flight

(LiDAR R/Tx solution)
LiDAR



Thank you



INNOVATIVE
SEMICONDUCTOR
SOLUTION PROVIDER